



関係各位

ISSM 組織委員会委員長  
株式会社東芝 常任顧問 斎藤 昇三  
ISSM 組織委員会副委員長  
東北大学 シニアリサーチフェロー/名誉教授 大見 忠弘  
ISSM 運営委員会委員長  
ISSM 会計委員長  
ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング 執行役員 井上 修一

## 第 22 回半導体生産技術国際シンポジウム「ISSM2014」協賛募金のお願いについて

拝啓 ますますご清祥の段、心よりお慶び申し上げます。

平素は、ISSM(半導体生産技術国際シンポジウム)にご厚情を賜りまして誠に有難うございます。

ISSM は皆様のご支援を賜り、これまでの 21 回の実績から半導体生産技術に関する最も重要な国際会議としての認知をいただき、半導体生産におけるメジャー会議としての位置づけを確立することができました。ISSM のテーマである半導体製造技術は、「作る技術」から「使う技術」へのシフトが益々重要となってきました。半導体製造技術全体を広く捉えて技術を評価し選択していくことが必要な今、ISSM は半導体製造全般の技術を網羅している特徴を活かし、異なる技術分野を統合化するシステム的なアプローチを評価できる唯一の国際会議として ISSM は半導体製造の発展に一層寄与していきたいと考えます。半導体生産技術の新たな課題にむけて、半導体産業界の有益な協調を推し進め、延いては半導体産業の新たな飛躍に資すること、また半導体産業の永続的な発展と繁栄に資することを目指して ISSM2014 を開催致します。ISSM2014 は、2014 年 12 月 2 日(火)～3 日(水)に、ハイアットリージェンシー東京での開催を予定しております。

シンポジウムの開催は参加費にて運営されることが本来の姿と考え、参加者にとって魅力ある企画の推進に努めておりますが、半導体の将来を担う若手技術者並びに学生の参加を積極的に募るには、低めの参加費設定も必要と考えております。我が国の会議場費の高コスト構造などの事情を勘案しますと、経費の大幅な節減を行いましても、参加費のみでシンポジウムを開催することは至難な状況です。

ISSM2014 に何卒、ご支援を頂きたく、ご寄付(協賛募金)にご協力賜りたく、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

敬 具

# ISSM2014

2014年12月2日(火)～3日(水)  
ハイアットリージェンシー東京(新宿)開催予定

## 開催趣意書

Version 1.0

# ISSM2014 開催趣旨

半導体産業は極めて大きな変革期に入っています。とくにこれまで長年半導体の推進役を果してきた“微細化技術”のトレンドに翳りが見え始め、今後は“微細化技術”に加えて、これからのネットワーク社会を支える中核技術としての新たな半導体デバイスを実現するために、新しい“半導体生産技術”の体系を構築することに大きな期待がかけられています。

“垂直統合”から“水平分業”へという産業構造の大きな変化と共に、成熟期“300mm”生産ラインのさらなる効率化、あるいは450mm次世代ウエハーサイズへの移行、デバイスの三次元化などの生産コスト削減やサイクルタイム削減などの動きは、「半導体産業の在り方」がその「生産性」をめぐって大きな転換期に入っていることを象徴しています。このような半導体産業の新たな発展の時代にあっては、「高品質、低コスト、高効率」の“半導体生産技術”が、競争力の要となると考えられます。さらに、その生産技術は、地球環境への配慮が強く求められています。

しかし、半導体の生産技術は、永らく「経験とノウハウの蓄積」に留まってきた経緯があり、「技術としての体系化、普遍化」は十分とは言い難く、半導体の生産技術にブレークスルーをもたらす、時代の要請に応じてゆくために、1992年よりISSM(International Symposium on Semiconductor Manufacturing)をスタート致しました。それ以来、ISSMは半導体の生産技術を、体系化、普遍化された技術体系として構築すること、すなわち「ノウハウをサイエンスに」することを目指して開催して参りました。その結果、新たな半導体生産技術の芽を育てると共に「生産技術のサイエンス化」という新しい流れを作りだしました。しかし、その道は未だ半ばであり、21世紀における半導体産業の再躍進を牽引する新たな生産技術革新へ向けて一層の強化が不可欠です。

ISSMは、応用物理学会(応用物理学会は、2000年より半導体基盤技術研究会(UCS)を後継)、米国のIEEE EDS、半導体製造装置・材料の国際的な工業会であるSEMI、この三者の共催の下に、1992年より日米で交互に毎年開催されてきた会議です。2011年よりはe-Manufacturing & Design Collaboration Symposiumと隔年でコラボレーションして「A joint Symposium with ISSM」として台湾にて開催しております。産業界や大学において、広く半導体の生産技術に関わる研究者、技術者が一堂に会し、

- 1) グローバリズムに立脚し
- 2) 技術の高度化への絶えざる挑戦を試み
- 3) 開発した技術を世に問い批判を仰ぐ

ことを基本スタンスとして、半導体の生産技術を発表、論議し、そして、技術者相互の交流と啓発、切磋琢磨を図って参りたいと念じております。これらにより、半導体の生産技術の強化と高度化の実現、延いては半導体産業の永続的な繁栄に資することを目的としております。

「半導体産業の研究開発に携わる技術者ならびに生産現場の技術者が一体となって、半導体の生産技術にブレークスルーをもたらす、半導体産業の永続的な繁栄を目指す」この試みに対し、関係各位のご理解とご協力、ならびに、研究開発と生産に関わる技術者、とくに次世代の半導体産業を担おうとする若手技術者の積極的な参加を強く期待します。

# ISSM2014 大綱

## 1. 会議の名称

(和文名称) 第 22 回半導体生産技術国際シンポジウム 2014

(英文名称) International Symposium on Semiconductor Manufacturing 2014

(略 称) ISSM2014

## 2. 主催機関などの名称

(主催) JSAP 応用物理学会

IEEE EDS

SEMI

(共催) TSIA

## 3. 会期と開催地(予定)

(1)会 期:2014 年 12 月 2 日(火)ー3 日(水)

(2)開催地:ハイアットリージェンシー東京(東京都新宿区)

## 4. 会議の性格と目的

「開催趣旨」のとおり

## 5. 経過と開催の意義

ISSM は、第 1 回を ISSMT'92 として日本で開催して以来、2008 年まで日米交互開催を実現して参りました。2009 年は欧州において他会議との併催が検討されましたが、経済情勢を鑑み開催中止となりました。2010 年、2014 年は予定どおり日本開催し、2011 年、2013 年は台湾にて e-Manufacturing & Design Symposium と共催にて開催されました。2014 年は開催時期をこれまでとは変更し、12 月に 2 日間にて開催されます。

20nm 以降の微細加工時代を迎えた現在、微細化の限界を克服するため半導体生産を基本原理から見直す必要性が生じています。また、地球環境を保護する生産技術も新たな課題となっています。半導体生産技術に関わる真摯な議論を継続して行ってきた国際会議「ISSM」の活動の意義は誠に大きいと言えます。

ISSM の試みは、“ノウハウをサイエンスに”を目指して、広く半導体生産技術に関わる技術者が一堂に会し、

1) グローバリズムに立脚し

2) 技術の高度化への絶えざる挑戦を試み

3) 開発した技術を世に問い議論をふかめ、さらにより良い成果を与える

を基本スタンスとして、半導体生産技術を発表、論議して参りました。また ISSM は技術者相互の交流と啓発、切磋琢磨を通じて、半導体産業の永続的な発展と繁栄に資することを目指そうとするものです。

「ISSM」は、UCS(半導体基盤技術研究会)がその草創を担い、その後、日本側では UCS、米国側では SEMI および IEEE EDS という、三者が国際会議としての立ち上げ定着を行いました。UCS の活動終了(2000 年度をもって満了)に伴い、替わって日本側主催団体は 2002 年以降、応用物理学会となっております。ISSM では関連研究者・技術者をさらに強力に糾合し、21 世紀の半導体生産技術の新たな課題にむけて、半導体産業界の有益な協調を推し進め、延いては半導体産業の新たな飛躍に資すること、また半導体産業の永続的な発展と繁栄に資することを目指して ISSM2014 を開催致します。

## 1. ISSM2014 会議の概要

(ア) 会議日程 2014 年 12 月 2 日(火)－3 日(水)

(イ) 会議内容(予定)

- ① キーノートセッション(基調講演)
- ② オーラルプレゼンテーションセッション(一般講演)
- ③ インターラクティブ・ポスターセッション
- ④ ネットワーキングセッション(ブース出展)

(ウ) 会議の主題(暫定):半導体生産技術

- ① **Fab Management**
  - ・ 工場設計および搬送自動化(FD)
  - ・ 製造ラインの戦略及び運営管理(MS)
  - ・ 生産管理および制御(MC)
  - ・ 環境・安全・健康(ES)
- ② **Process Integration**
  - ・ プロセスおよび材料の最適化(PO)
  - ・ 歩留まり向上(YE)
  - ・ 汚染防止及びウルトラクリーンテクノロジー(UC)
  - ・ プロセス制御・モニタリング(PC)
  - ・ 製造装置・測定装置(PE)
  - ・ 生産性設計(DM)
- ③ **Final Manufacturing**
  - ・ ファイナル・マニュファクチャリング(FM)

(エ) ISSM2014 のハイライト・テーマ

現在注目の技術に関しては、採択論文決定後にハイライト・テーマとしてそれらをくくり、エリアを横断的にカバーする別セッションとしてプログラムを構成します。

- ・ **Big Data** (ビッグデータ)
- ・ **3DIC (TSV and all other 3D)**
- ・ **Printed Electronics** (プリンテッド・エレクトロニクス)
- ・ **Power Devices** (パワー半導体)

(オ) 参加予定国: 日本, 米国, 欧州諸国, アジア諸国, その他

(カ) 参加予定者

日本、欧米、アジアなどから 250 名

(キ) 会議公用語

講演	英語
印刷物	英語

## ISSM2014 委員会組織 (敬称略)

### 組織委員会

ISSM組織委員会				
委員長	斎藤 昇三	(株)東芝		取締役 代表執行役副社長
副委員長	大見 忠弘	東北大学	未来科学技術共同研究センター	シニアリサーチフェロー、名誉教授
運営兼務	堀岡 啓治	アプライドマテリアルズジャパン(株)		技師長
	伊藤 義武	オムロン(株)	マイクロデバイス事業部 生産技術部	部長
	井上 道弘	(独)産業技術総合研究所	九州産学官連携センター	イノベーションコーディネータ
運営兼務	内田 博文	大日本スクリーン製造(株)	半導体機器カンパニー	カンパニー副社長
運営兼務	貝塚 考亘	東京エレクトロン(株)	先端プロセス開発センター	センター長
運営兼務	海本 博之	パナソニック(株)	デバイス社 半導体事業グループ マニュファクチャリング統括部 プロセス開発センター	センター所長
	鶴丸 哲哉	ルネサスエレクトロニクス(株)		取締役執行役員 兼 生産本部本部長
運営兼務	井上 修一	ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング(株)	執行役員	
	西村 正	東京工業大学大学院	理工学研究科電気電子専攻	連携教授、工学博士

### 運営委員会

ISSM運営委員会				
委員長	井上 修一	ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング(株)		執行役員
副委員長	平山 誠	State University of New York	College of Nanoscale Science and Engineering	Professor
	堀岡 啓治	アプライドマテリアルズジャパン(株)		技師長
	北野 直樹	インテル(株)	技術開発・製造技術本部	技術戦略担当部長
	清水 正男	オムロン(株)	マイクロデバイス事業部	技術専門職 工学博士
	中川 洋一	SEMIジャパン		代表
	内田 博文	大日本スクリーン製造(株)	半導体機器カンパニー	カンパニー副社長
	売賀 賢介	(株)デュラシステムズ		代表取締役社長
	服部 毅	電子ジャーナル		編集顧問
	貝塚 考亘	東京エレクトロン(株)	先端プロセス開発センター	センター長
	森岡 國男	(一社)日本半導体製造装置協会		専務理事
	海本 博之	パナソニック(株)	生産本部 プロセス開発センター	所長
	岡村 格太郎	(一社)半導体産業研究所	企画部、総務部	部長
	前川 耕司	PDFソリューションズ(株)	Japan Business Development	Vice President
	中馬 宏之	一橋大学	イノベーション研究センター	教授
	神澤 公	ローム(株)	研究開発本部	副本部長

## プログラム委員会

ISSMプログラム委員会				
委員長	内野 敏幸	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部 生産統括部 アウトソース計画部	部長
委員長代行	嶋崎 綾子	(株)東芝	セミコンダクター & ストレージ社 四日市工場 解析・検査計測技術部	主幹
副委員長	小池 英敏	東芝メモリシステムズ(株)	イメージセンサ製品技術部 イメージセンサ製品技術第一担当	グループマネージャー
幹事会委員	加藤 凡典	(有) エー・アイ・ティ		代表取締役
幹事会委員	小澤 克敏	オムロン(株)	グローバルSCM&IT革新本部 IT革新センタ 生産情報システム部	部長
幹事会委員	南百瀬 勇	オムロン(株)	グローバルものづくり革新センター 品質革新センタ	
幹事会委員	今井 伸一	パナソニック(株)	R&D本部 デバイスソリューションセンター アメニティデバイスグループ	主幹技師 工学博士
	水野 晋介	アプライドマテリアルズジャパン(株)	PDCプロダクトマネージメント	マネージャー
	青木 正身	ケーエルエー・テンコール(株)	プロセス・コントロール・ソリューションズ	アジア・リージョナル・ディレクター
	赤石 実	オンセミコンダクター	製造技術開発支援部	プロジェクトマネージャー
	新保 正博	オン・セミコンダクター	技術統括部 プロセス技術開発部	主任技術員
	三宅 賢治	株式会社ビーエムティー	経営企画室	室長
	江上 卓	ソニーセミコンダクタ(株)	熊本TEC 生産技術部門 FAシステム1部 熊本MES技術課	統括課長
	斉藤 美佐子	東京エレクトロン(株)	技術開発センター コンタミ制御グループ	グループリーダー
	井上 弘之	日本テキサス・インスツルメンツ(株)	FAB Product Engineering/Process Integration	PI リーダー
	西谷 英輔	(株)日立国際電気	研究開発本部 半導体装置システム研究所	主管研究員
	渡辺 健二	(株)日立ハイテクノロジーズ	電子デバイスシステム事業統括本部 評価装置営業本部	センタ長
	安井 孝俊	パナソニック・タワージャズセミコンダクター(株)	プロセステクノロジーセンター プロセスグループ	主幹技師
	秋元 健司	ルネサス セミコンダクタ マニファクチュアリング(株)	技術統括部 プロセス加工技術部	部長
	片山 俊治	ルネサス セミコンダクタ マニファクチュアリング(株)	技術統括部 解析評価技術部 故障解析第一課	課長
	横田 和樹	ルネサスエレクトロニクス(株)	生産本部 デバイス開発統括部 プロセス技術部 プロセス技術第二課	課長
	山本 悦章	ルネサスセミコンダクタマニファクチュアリング(株)	技術統括部/プロセス成膜技術部/配線技術課	課長
	竹井 祥司	ローム(株)	LSI生産本部 LSI生産本部 LSI製造部 NVM技術課	技術員
	大地 宏明	ローム(株)	LSI生産本部 LSI製造部	

## eMDC (e-Manufacturing & Design Collaboration Conference)/TSIA 協力メンバー

Name	Affiliation
Dr. Nicky C.C. Lu	Chairman & CEO, Etron Technology, Inc./Managing Board Director, TSIA
Dr. TY Wu	President, TSIA
Ms. Celia Shih	TSIA
Mr. Thomas Chen	tsmc
Mr. Robert Chien	tsmc
Dr. C. Hsu	tsmc
Prof. SC Chang	National Taiwan University
Prof. Argon Chen	National Taiwan University

**【ISSM2014 協賛金特典内容】**

	プラチナ	ゴールド	シルバー	ブロンズ
協賛金	¥800,000	¥600,000	¥400,000	¥200,000
<b>ISSM2014 参加</b>				
ISSM2014 への無料参加	6	4	2	1
<b>ISSM2014 ロゴ掲載</b>				
ISSM2014 ウェブサイト (ロゴから企業 HP へリンク)	上段	中段(上)	中段(下)	下段
予稿集に企業ロゴ掲載、ホームページへリンク	有	有	有	有
インターバルスクリーン上の企業ロゴを表示	有	有	有	有
会場ポスターに企業ロゴを表示	有	有	有	有
<b>テーブルトップ展示</b>				
テーブル・ホワイトボード	有	有	有	有

■ISSM 事務局

株式会社セミコンダクタポータル

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5 メソニック 39MT ビル4階

Tel: 03-5733-4971 Fax: 03-5733-4973 E-mail: [issm\\_2014@semiconportal.com](mailto:issm_2014@semiconportal.com)



返信先 ISSM 日本事務局 03-5733-4973 または [issm\\_2014@semiconportal.com](mailto:issm_2014@semiconportal.com)

申込日付 月 日

ISSM2014 開催主旨にご賛同を賜り、協賛募金にご協力頂ける場合、本用紙にご記入の上、ISSM 事務局宛にご返送の程お願い申し上げます。

## 第 22 回半導体生産技術国際シンポジウム「ISSM2014」協賛募金

ISSM2014 開催に際して、下記のとおり協賛募金に協力いたします。

プラチナスポンサー: 800,000 円

ゴールドスポンサー: 600,000 円

シルバースポンサー: 400,000 円

ブロンズスポンサー: 200,000 円

テーブルトップブース(テーブル・ホワイトボード)ご利用の有無 ( 有 ・ 無 )

貴社名 \_\_\_\_\_  
(日英共にご記入ください)

Company \_\_\_\_\_  
(日英共にご記入ください)

ご担当者名 \_\_\_\_\_

部課役職名 \_\_\_\_\_

住所 〒 \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

請求書発行希望月 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月

★ お支払い方法について: ご回答を頂き次第、請求書を事務局よりお送りさせていただきます。  
ご協力に心より感謝申し上げます。

本件のお問合せ、返送先:

ISSM 日本事務局 (株)セミコンダクタポータル

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-4-5 メソニック 39MT ビル 4F

Tel:03-5733-4971, Fax:03-5733-4973, E-mail:[issm\\_2014@semiconportal.com](mailto:issm_2014@semiconportal.com)